

Silberlotflussmittel nach DIN EN 1045 (DIN 8511)



Die im FONTARGEN-Programm enthaltenen Flussmittel sind den Arbeitstemperaturen der Silberlote angepasst und auf die zu lötenden Grundwerkstoffe abgestimmt.

F 300 (FH 10 / F-SH1) weißes Pulver, korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, legierte und unlegierte Stähle. Das Pulver lässt sich mit destilliertem Wasser zu einer streichfähigen Flussmittelpaste anrühren.

F 300 H Ultra (FH 10 / F-SH1) weiße streichfähige Paste, korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, legierte und unlegierte Stähle.

F 300 H Ultra NT (FH 10 / F-SH1) weiße dosierfähige, nicht toxische Paste korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, legierte und unlegierte Stähle. Besonders für maschinelles Löten, z.B. auf Flammlötanlagen geeignet.

F 300 HF Ultra (FH 12 / F-SH1) dunkle streichfähige Paste, korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, legierte und unlegierte Stähle, sowie Hartmetalle. Besonders für höhere Temperaturen bis max. 850 °C geeignet.

F 300 DN (FH 10 / F-SH1) weiße dosierfähige Paste, korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, legierte und unlegierte Stähle. Besonders für maschinelles Löten, z.B. auf Flammlötanlagen geeignet.

F 3400 S (nicht genormt) klare sprühfähige Flüssigkeit, leicht korrosiv zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen. Flussmittel zur Unterstützung des Lotflusses bei Lötungen mit Rapidflux und Kupfer-Phosphor-(Silber)-Loten.

13/10/JL/1